

NEW ETF Line-up

HBM, 반도체 소부장, 美 메모리/에이전틱 AI 등
ETF 4종 상장

9월 3주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 | RA 조호준



✓ New ETF 개요

상장 개요

'26.9.15(화) 국내 증시에 ETF 4종목 신규 상장

*상장일(2026. 9. 15) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,171종목

상품 요약

▲ PLUS 코리아HBM반도체 (0239Y0)

- 국내 메모리반도체 제조사 및 장비·기판·소재기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF

▲ PLUS AI반도체소부장액티브 (0239Z0)

- 국내 AI반도체 산업 성장에 따라 수혜가 기대되는 소재·부품·장비 기업에 투자하는 액티브 ETF

▲ KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 (0238F0)

- 미국 메모리 및 스토리지 관련 기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF

▲ HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ (0227L0)

- 미국 에이전틱AI* 모델 개발 및 관련 서비스 기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF

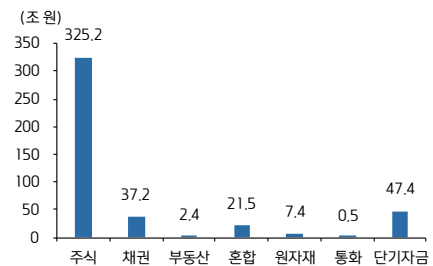
*에이전틱AI: 목표달성을 위해 '인지-계획 수립-실행'을 스스로 수행하는 AI

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.09.04~09.11	'26.08.28~09.04
상장 종목 수	1168 개 (▲1 개)	1167 개
순자산 총액	448.4 조 원 (▲4.8 조)	443.6 조 원
총 거래량	367.7 억 주 (▼52.7 억)	420.4 억 주
총 거래대금	90.4 조 원 (▲12.9 조)	77.5 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.9.11 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.9.11 기준

신규 출시 ETF 개요 (1)

구분	PLUS 코리아 HBM 반도체	PLUS AI 반도체소부장액티브
코드	0239Y0	0239Z0
상품 유형	주식형	주식형
운용사	한화자산운용	한화자산운용
기초(비교) 지수	Akros 한국 HBM 반도체 지수	Akros 한국 AI 반도체 소부장 지수
복제방법	실물 (패시브)	실물 (액티브)
총보수 (운용보수)	0.450% (0.409%)	0.630% (0.589%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	30종목
정기 변경	비중결정일: 연 4회(2, 5, 8, 11월 마지막 영업일) 수행일: 비중결정일로부터 3영업일 후	비중결정일: 연 4회(2, 5, 8, 11월 마지막 영업일) 수행일: 비중결정일로부터 5영업일 후

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

신규 출시 ETF 개요 (2)

구분	KODEX 미국 AI 메모리 TOP2플러스	HANARO 미국에이전틱 AI TOP2+
코드	0238F0	0227L0
상품 유형	주식형	주식형
운용사	삼성자산운용	NH-Amundi 자산운용
기초(비교) 지수	Akros 미국 AI 메모리 TOP2 플러스 지수	Indxx US Agentic AI Top2+ Index
복제방법	실물 (패시브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.550% (0.519%)	0.450% (0.400%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	10종목
정기 변경	비중결정일: 연 4회(3, 6, 9, 12월의 읍선 만기일로부터 5영업일 전) 수행일: 비중결정일로부터 5영업일 후	종목선정일: 수행일 직전월 마지막 금요일 비중결정일: 수행일 7거래일 전 수행일: 매년 2, 5, 8, 11월 2주차 금요일

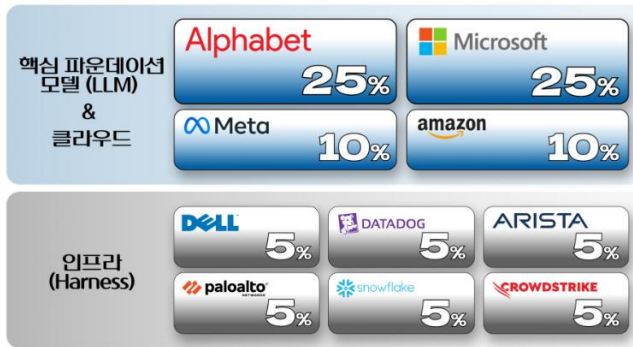
자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

| 신규 출시 ETF 한 눈에 보기

ETF 명 (코드)	PLUS 코리아HBM반도체 (0239Y0)																																																							
개요	- 국내 메모리 반도체 제조사 및 장비·기판·소재기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF																																																							
특징	- 국내 HBM 대표 기업과 메모리 설비투자 연관성이 높은 밸류체인 내 소부장 기업에 투자																																																							
기초지수	- Akros 한국 HBM 반도체 지수																																																							
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 유가증권 및 코스닥시장 상장 보통주 중 - 시가총액 2,000억원 이상 및 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상 ▶ 선정기준: 유니버스 종목의 HBM Value Chain* 키워드 유사도 절대 점수 1.0 종목 중 상위 10개 종목 - 10개 미만일 경우 0.5점 종목 포함 * HBM 제조사와 이들의 생산에 필요한 공급사 포괄. 고대역폭 메모리 또는 그 기반이 되는 DRAM과 같은 메모리 소자를 직접 제조하는 기업과 제조 장비, 기판 및 회로기판 공급사가 편입 대상이 됨. 편입 대상 공급사는 증착, 식각, 스트립 및 어닐링 등 메모리 제조 공정 장비, 메모리 패키지 기판 및 회로 기판 또는 다이 적층 및 본딩 장비를 제조하는 기업을 의미 ▶ 비중결정방식 - 상위 2종목 각 25%. 나머지 8종목은 비중 50% 동일 가중으로 배분(종목당 6.25%)																																																							
출시 배경 및 투자포인트	▶ AI 핵심 병목 HBM, 한국 양대 메모리 대표기업에 투자: AI 연산 고도화가 만드는 공통 병목은 '연산능력'이 아니라 '데이터 공급속도'. GPU와 ASIC은 경쟁하지만 HBM은 양 진영 모두에 필요한 핵심 인프라. 슈퍼칩 세대가 올라갈수록 BOM 내 메모리 원가 비중(GB300 53% → VR200 62% → VR300 77%)이 상승해 메모리 제조사의 협상력이 강화되는 구조. HBM 시장은 '25년 \$350억 → '26년 \$680억 → '27년 \$1,000억 이상으로 성장 전망이며, '26년 1분기 기준 글로벌 HBM 시장 내 점유율은 SK하이닉스 58%·삼성전자 21%로 두 회사가 약 80%를 장악 ▶ AI 메모리 설비투자 확대가 국내 소부장 수요로 연결: 하이퍼스케일러 5사 CapEx가 2024년 \$2,240억에서 2028E \$1조 300억으로 늘어나면서 그 중 메모리 비중도 15% → 73%로 상승 전망. 메모리 제조사도 삼성전자 110조원+, SK하이닉스 54.3조원 규모의 투자 계획을 발표. 이 CapEx는 전공정 장비 발주 → 첨단 패키징·테스트 → 가동을 상상에 따른 소재·기판 수요로 순차 확산 전망. 여기에 LTA 확산으로 SK하이닉스는 매출의 약 50%, 삼성전자는 생산물량의 60~70%를 선 확보하며 사이클 산업이라는 의심을 넘어 구조적 성장 국면으로 전환 중 ▶ 국내 HBM 대표기업과 핵심 소부장을 담은 10종목 포트폴리오: '삼성전자'·'SK하이닉스'를 합산 50% 편입해 HBM 제조 리더를 코어로 보유하고, 나머지 50%는 HBM·메모리 생산 관련 국내 장비·소재·부품·기판 기업으로 구성. 특히 Top2의 메모리 생산·설비투자 연관성이 높은 밸류체인 기업에 집중. 주도 영역이 전공정 장비 → 첨단 패키징 → 테스트·검사 → 소재·기판으로 순환하는 만큼, 특정 공정에 몰지 않고 사이클 전반을 담도록 설계																																																							
참고자료	'PLUS 코리아HBM반도체 ETF' 구성종목 예시 <table><tr><th>NO</th><th>구성종목</th><th>비중</th><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>1</td><td>삼성전자</td><td>25.3%</td><td>메모리반도체</td><td>HBM-D램·낸드 글로벌 HBM 시장점유율 2위 종합 반도체-전자 제조사</td></tr><tr><td>2</td><td>SK하이닉스</td><td>22.5%</td><td>메모리반도체</td><td>HBM-D램·낸드 글로벌 HBM 시장점유율 1위 국내 대표 메모리 반도체 제조사</td></tr><tr><td>3</td><td>피에스케이</td><td>10.0%</td><td>전공정</td><td>장비 Strip/Ashing(감광액 제거) 및 Dry Cleaning(건식 세정) 장비 분야 글로벌 선두 기업</td></tr><tr><td>4</td><td>브이엘</td><td>8.5%</td><td>전공정</td><td>장비 300mm 실리콘-금속막 건식 식각장비(Dry Etcher)를 주력으로 하는 장비 기업</td></tr><tr><td>5</td><td>테스</td><td>8.3%</td><td>전공정</td><td>장비 PECVD(증착) 및 Gas Phase Etch&Cleaning(식각·세정) 장비 기업</td></tr><tr><td>6</td><td>원익PS</td><td>7.0%</td><td>전공정</td><td>장비 PECVD-ALD 등 증착 장비와 Diffusion Thermal System(열처리) 장비 기업</td></tr><tr><td>7</td><td>삼백</td><td>5.4%</td><td>후공정</td><td>부품 메모리 모듈용 반도체 패키지 서브스트레이트(기판)를 생산하는 기판 전문 기업</td></tr><tr><td>8</td><td>주성엔지니어링</td><td>4.8%</td><td>전공정</td><td>장비 반도체용 증착(ALD 등) 장비 및 디스플레이·태양전지 장비 기업</td></tr><tr><td>9</td><td>이수페타시스</td><td>4.4%</td><td>후공정</td><td>부품 AI 서버·데이터센터·네트워크 스위치용 초고다층 MLB(다층인쇄회로기판) 전문 제조사</td></tr><tr><td>10</td><td>대덕전자</td><td>3.9%</td><td>후공정</td><td>부품 반도체 패키지 기판(FC-BGA 등)과 PCB(인쇄회로기판)을 생산하는 기판 전문 기업</td></tr></table> 자료: Counterpoint Research, 한화자산운용 주) 2026.07.31, 구성종목은 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음	NO	구성종목	비중	구분	내용	1	삼성전자	25.3%	메모리반도체	HBM-D램·낸드 글로벌 HBM 시장점유율 2위 종합 반도체-전자 제조사	2	SK하이닉스	22.5%	메모리반도체	HBM-D램·낸드 글로벌 HBM 시장점유율 1위 국내 대표 메모리 반도체 제조사	3	피에스케이	10.0%	전공정	장비 Strip/Ashing(감광액 제거) 및 Dry Cleaning(건식 세정) 장비 분야 글로벌 선두 기업	4	브이엘	8.5%	전공정	장비 300mm 실리콘-금속막 건식 식각장비(Dry Etcher)를 주력으로 하는 장비 기업	5	테스	8.3%	전공정	장비 PECVD(증착) 및 Gas Phase Etch&Cleaning(식각·세정) 장비 기업	6	원익PS	7.0%	전공정	장비 PECVD-ALD 등 증착 장비와 Diffusion Thermal System(열처리) 장비 기업	7	삼백	5.4%	후공정	부품 메모리 모듈용 반도체 패키지 서브스트레이트(기판)를 생산하는 기판 전문 기업	8	주성엔지니어링	4.8%	전공정	장비 반도체용 증착(ALD 등) 장비 및 디스플레이·태양전지 장비 기업	9	이수페타시스	4.4%	후공정	부품 AI 서버·데이터센터·네트워크 스위치용 초고다층 MLB(다층인쇄회로기판) 전문 제조사	10	대덕전자	3.9%	후공정	부품 반도체 패키지 기판(FC-BGA 등)과 PCB(인쇄회로기판)을 생산하는 기판 전문 기업
NO	구성종목	비중	구분	내용																																																				
1	삼성전자	25.3%	메모리반도체	HBM-D램·낸드 글로벌 HBM 시장점유율 2위 종합 반도체-전자 제조사																																																				
2	SK하이닉스	22.5%	메모리반도체	HBM-D램·낸드 글로벌 HBM 시장점유율 1위 국내 대표 메모리 반도체 제조사																																																				
3	피에스케이	10.0%	전공정	장비 Strip/Ashing(감광액 제거) 및 Dry Cleaning(건식 세정) 장비 분야 글로벌 선두 기업																																																				
4	브이엘	8.5%	전공정	장비 300mm 실리콘-금속막 건식 식각장비(Dry Etcher)를 주력으로 하는 장비 기업																																																				
5	테스	8.3%	전공정	장비 PECVD(증착) 및 Gas Phase Etch&Cleaning(식각·세정) 장비 기업																																																				
6	원익PS	7.0%	전공정	장비 PECVD-ALD 등 증착 장비와 Diffusion Thermal System(열처리) 장비 기업																																																				
7	삼백	5.4%	후공정	부품 메모리 모듈용 반도체 패키지 서브스트레이트(기판)를 생산하는 기판 전문 기업																																																				
8	주성엔지니어링	4.8%	전공정	장비 반도체용 증착(ALD 등) 장비 및 디스플레이·태양전지 장비 기업																																																				
9	이수페타시스	4.4%	후공정	부품 AI 서버·데이터센터·네트워크 스위치용 초고다층 MLB(다층인쇄회로기판) 전문 제조사																																																				
10	대덕전자	3.9%	후공정	부품 반도체 패키지 기판(FC-BGA 등)과 PCB(인쇄회로기판)을 생산하는 기판 전문 기업																																																				

ETF 명 (코드)		PLUS AI반도체소부장액티브 (0239Z0)																																					
개요	- 국내 AI반도체 산업 성장에 따라 수혜가 기대되는 소재·부품·장비 기업에 투자하는 액티브 ETF																																						
특징	- 반도체 소부장 종목 내 전·후공정 간 병목 이동에 따라 종목과 비중을 능동 조정																																						
비교지수	- Akros 한국 AI 반도체 소부장 지수																																						
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 유가증권 및 코스닥시장 상장 보통주 중 - 시가총액 2,000억원 이상 및 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상																																						
	▶ 선정기준: 전공정·후공정 각 부문 키워드 유사도 절대 점수 1.0 종목(핵심 후보군) 중 총 30개 종목 - 두 부문 모두 1.0점인 종목은 부문 내 상대 순위가 높은 부문에 배정 (중복 제거) - 중복 제거 후 두 후보군 규모에 비례하여 30개 배분, 각 부문 내 유사도 상위 상위부터 편입 - 핵심 후보군 합집합이 30개 미만일 경우 평가 가능한 핵심 후보군 전부 편입 - 15개 미만일 경우 두 부문 0.5점 종목을 한 집합으로 모아 두 부문 점수 중 높은 값 기준 순위로 최소 15개까지 추가 편입																																						
출시 배경 및 투자포인트	▶ 비중결정방식: 혼합점수 = 키워드 유사도 점수 x 50% + 유동시가총액 점수 x 50%에 비례 배분 - 유동시가총액점수 = 유동시가총액 / max(유동시가총액) - 종목별 비중 최소 0.5%, 최대 8% 제한																																						
	▶ AI 산업 Big Cycle의 수혜가 소부장 전반으로 확산: AI·HBM 수요 확대 → 메모리 CapEx·공정 전환 → 장비 발주 → 가동률 상승에 따른 소재·부품 반복 수요로 이어지는 구조. 반도체 8대 공정마다 복수의 소재·부품·장비 기업이 참여하는 만큼, 메모리 증설과 생산 확대의 수혜가 밸류체인 전반의 성장으로 연결. 실제로 편입종목 평균 매출액 증가율이 2026E 44%·2027E 38%, 영업이익 증가율 2026E 539%·2027E 71%로 코스피200(삼성전자·SK하이닉스 제외) 대비 뚜렷하게 차별화																																						
참고자료	▶ 병목의 이동이 위너를 바꾼다: 병목은 단순한 공정 순서가 아니라 고객사의 투자 집행·양산 전환·수율 확보 단계에 따라 이동. 증설 초기에는 증착·식각·계측 등 전공정 장비가, 양산 고도화 단계에서는 적층·분당·검사·기판 등 후공정과 소모성 소재·부품이 부각되며 수혜 영역이 순환. 실제 연도별 수익률 TOP5 종목도 공급부족·설비증설(2021년)에서 생성형 AI 확산(2023년), HBM 고단화(2024년), 첨단 패키징 확대(2025년), 반도체 수출 경쟁(2026년)으로 주도주가 계속 교체됐고, 2021~2026년 평균수익률 상위 종목 47개 vs 하위 83개로 선별 자체가 성과를 가름. 액티브 운용 방식을 채택하여 수주·수율·가동률·CAPEX·신기술 채택 신호에 따라 종목과 비중을 능동 조정하고, 비교지수에 없는 브이엠(식각)·파크시스템스(계측)·한화비전·기가비스(첨단 패키징) 등 병목 인접 종목도 리서치 기반으로 편입																																						
	▶ 특정 공정 편중을 뚫은 분산형 소부장 포트폴리오: 패시브 소부장 상품들이 전공정 99.6% 또는 후공정 91~99%로 한쪽에 쏠리고 Top5 비중이 66~79%에 달하는 반면, 이 상품은 Top5 비중 26.2%로 낮추고 전·후공정을 병목 이동에 따라 능동 조정. PLUS ETF 반도체 라인업 중에서도 글로벌HBM반도체(글로벌 메모리 3대장) → SK하이닉스샌디스크채권혼합50(연금형) → 코리아HBM반도체(대형 메모리+국내 밸류체인) → 소부장액티브(분산형·공정별 유연 대응)로 이어지는 스펙트럼의 가장 끝에 위치																																						
‘PLUS AI반도체소부장액티브 ETF’ 유니버스 구성종목 예시																																							
<table><tr><th>종목명</th><th>공장·영역</th><th>특징</th></tr><tr><td>원익 IPS</td><td>전공정·장비</td><td>ALD(원자층)·CVD/PECVD(화학기상·플라즈마) 등 핵심 증착장비 공급. 삼성전자·SK하이닉스의 공정 전환과 설비투자 확대 수혜</td></tr><tr><td>브이엠</td><td>전공정·장비</td><td>300mm 웨이퍼용 폴리실리콘·금속·산화막 건식 식각장비 전문기업. 미세화·고단화에 따른 식각장비 수요 증가 수혜</td></tr><tr><td>HPSP</td><td>전공정·장비</td><td>고압 수소 어닐링(열처리) 장비 전문기업. 미세공정에서 반도체막의 결함을 줄이고 성능을 개선하는 핵심 장비로, 선단 로직·메모리 공정 고도화 수혜</td></tr><tr><td>파크시스템스</td><td>전공정·장비</td><td>원자현미경 기반 반도체 표면·박막·포토마스크 정밀 측정. 미세공정 고도화와 수율 관리 중요성 확대에 따른 계속 수요 증가</td></tr><tr><td>피에스케이홀딩스</td><td>후공정·장비</td><td>디스립(잔여물 제거)·벤트 리플로우 장비 공급. 글로벌 메모리 고객 기반으로 HBM·첨단 패키징 투자 확대 수혜</td></tr><tr><td>한화비전</td><td>후공정·장비</td><td>자회사 한화세미텍을 통해 몰입집·TC·하이브리드 본드 공급. SK하이닉스형 납땜을 기반으로 HBM·첨단 패키징 장비사업 확대</td></tr><tr><td>기가비스</td><td>후공정·장비</td><td>반도체 기반용 자동광학검사·수리 및 자동화 장비 전문기업. FC-BGA·웨이퍼/패널레벨 패키징 고도화에 따른 정밀 검사 수요 확대</td></tr><tr><td>삼성전기</td><td>후공정·부품</td><td>FC-BGA 등 고부가 패키지기판 생산. AI 서버·고성능 컴퓨팅용 대면적·고다중 기판 수요 증가 수혜</td></tr><tr><td>대덕전자</td><td>후공정·부품</td><td>FC-BGA 등 반도체 패키지기판이 핵심 사업. CPU·GPU·AI 가속기용 고사양 기판 수요 확대의 직접 수혜</td></tr><tr><td>이수퍼다시스</td><td>후공정·부품</td><td>프로브카드용 PCB·로드보드·반인보드 등 반도체 테스트용 PCB 생산. AI·고성능 반도체 확산에 따른 테스트 복잡도 상승과 고사양 테스트 보드 수요 확대 수혜</td></tr><tr><td>두산테스나</td><td>후공정·테스트</td><td>웨이퍼·패키지 테스트 중심의 후공정 전문기업. 시스템반도체 출하 증가와 테스트 복잡도 상승 수혜</td></tr></table>				종목명	공장·영역	특징	원익 IPS	전공정·장비	ALD(원자층)·CVD/PECVD(화학기상·플라즈마) 등 핵심 증착장비 공급. 삼성전자·SK하이닉스의 공정 전환과 설비투자 확대 수혜	브이엠	전공정·장비	300mm 웨이퍼용 폴리실리콘·금속·산화막 건식 식각장비 전문기업. 미세화·고단화에 따른 식각장비 수요 증가 수혜	HPSP	전공정·장비	고압 수소 어닐링(열처리) 장비 전문기업. 미세공정에서 반도체막의 결함을 줄이고 성능을 개선하는 핵심 장비로, 선단 로직·메모리 공정 고도화 수혜	파크시스템스	전공정·장비	원자현미경 기반 반도체 표면·박막·포토마스크 정밀 측정. 미세공정 고도화와 수율 관리 중요성 확대에 따른 계속 수요 증가	피에스케이홀딩스	후공정·장비	디스립(잔여물 제거)·벤트 리플로우 장비 공급. 글로벌 메모리 고객 기반으로 HBM·첨단 패키징 투자 확대 수혜	한화비전	후공정·장비	자회사 한화세미텍을 통해 몰입집·TC·하이브리드 본드 공급. SK하이닉스형 납땜을 기반으로 HBM·첨단 패키징 장비사업 확대	기가비스	후공정·장비	반도체 기반용 자동광학검사·수리 및 자동화 장비 전문기업. FC-BGA·웨이퍼/패널레벨 패키징 고도화에 따른 정밀 검사 수요 확대	삼성전기	후공정·부품	FC-BGA 등 고부가 패키지기판 생산. AI 서버·고성능 컴퓨팅용 대면적·고다중 기판 수요 증가 수혜	대덕전자	후공정·부품	FC-BGA 등 반도체 패키지기판이 핵심 사업. CPU·GPU·AI 가속기용 고사양 기판 수요 확대의 직접 수혜	이수퍼다시스	후공정·부품	프로브카드용 PCB·로드보드·반인보드 등 반도체 테스트용 PCB 생산. AI·고성능 반도체 확산에 따른 테스트 복잡도 상승과 고사양 테스트 보드 수요 확대 수혜	두산테스나	후공정·테스트	웨이퍼·패키지 테스트 중심의 후공정 전문기업. 시스템반도체 출하 증가와 테스트 복잡도 상승 수혜
종목명	공장·영역	특징																																					
원익 IPS	전공정·장비	ALD(원자층)·CVD/PECVD(화학기상·플라즈마) 등 핵심 증착장비 공급. 삼성전자·SK하이닉스의 공정 전환과 설비투자 확대 수혜																																					
브이엠	전공정·장비	300mm 웨이퍼용 폴리실리콘·금속·산화막 건식 식각장비 전문기업. 미세화·고단화에 따른 식각장비 수요 증가 수혜																																					
HPSP	전공정·장비	고압 수소 어닐링(열처리) 장비 전문기업. 미세공정에서 반도체막의 결함을 줄이고 성능을 개선하는 핵심 장비로, 선단 로직·메모리 공정 고도화 수혜																																					
파크시스템스	전공정·장비	원자현미경 기반 반도체 표면·박막·포토마스크 정밀 측정. 미세공정 고도화와 수율 관리 중요성 확대에 따른 계속 수요 증가																																					
피에스케이홀딩스	후공정·장비	디스립(잔여물 제거)·벤트 리플로우 장비 공급. 글로벌 메모리 고객 기반으로 HBM·첨단 패키징 투자 확대 수혜																																					
한화비전	후공정·장비	자회사 한화세미텍을 통해 몰입집·TC·하이브리드 본드 공급. SK하이닉스형 납땜을 기반으로 HBM·첨단 패키징 장비사업 확대																																					
기가비스	후공정·장비	반도체 기반용 자동광학검사·수리 및 자동화 장비 전문기업. FC-BGA·웨이퍼/패널레벨 패키징 고도화에 따른 정밀 검사 수요 확대																																					
삼성전기	후공정·부품	FC-BGA 등 고부가 패키지기판 생산. AI 서버·고성능 컴퓨팅용 대면적·고다중 기판 수요 증가 수혜																																					
대덕전자	후공정·부품	FC-BGA 등 반도체 패키지기판이 핵심 사업. CPU·GPU·AI 가속기용 고사양 기판 수요 확대의 직접 수혜																																					
이수퍼다시스	후공정·부품	프로브카드용 PCB·로드보드·반인보드 등 반도체 테스트용 PCB 생산. AI·고성능 반도체 확산에 따른 테스트 복잡도 상승과 고사양 테스트 보드 수요 확대 수혜																																					
두산테스나	후공정·테스트	웨이퍼·패키지 테스트 중심의 후공정 전문기업. 시스템반도체 출하 증가와 테스트 복잡도 상승 수혜																																					
자료: Akros Technologies, 한화자산운용 주) 구성종목은 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음																																							

ETF 명 (코드)	KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 (0238F0)														
개요	- 미국 메모리 및 스토리지 관련 10종목에 투자하는 패시브 ETF														
특징	- 美 SSD·HDD 메모리 대표 4개사와 관련 기업에 집중 투자														
기초지수	- Akros 미국 AI메모리 TOP2 플러스 지수														
종목 선정 기준	▶ 유니버스: NYSE 또는 NASDAQ 상장 보통주 또는 ADR 중 - 시가총액 10억 달러 이상 및 3개월 평균 일 거래대금 100만 달러 이상 ▶ 선정기준: Memory* 키워드 NEXUS 절대점수 1.0인 종목(핵심군) 우선 편입, 총 10종목 - 절대점수 0.5점 미만 종목은 제거 - 핵심군이 10개 미만일 경우 0.5점 종목(보완군)을 NEXUS 유사도 순위 높은 순으로 추가 * 디지털 데이터를 저장하는 장치를 설계·제조하는 것을 핵심 산업으로 하는 기업. DRAM, HBM 등 휘발성 메모리와 비휘발성 플래시 메모리 및 SSD, HDD 포함 ▶ 비중결정방식: 유사도 순위 상위 2종목 각 25% 고정, 나머지 8종목은 잔여 50%를 혼합점수에 비례 배분 - 각 종목의 비중은 0.5%에서 18% 범위로 제한. 상·하한을 벗어나는 비중은 해당 한도로 조정하고 그 초과·부족분은 나머지 잔여군 종목에 재배분														
출시 배경 및 투자포인트	▶ AI 고도화로 기하급수적으로 늘어날 데이터 저장 수요: GPU·CPU 연산은 작업이 끝나면 자원을 회수해 다음 작업에 재사용하는 순환 구조인 반면, AI가 생성한 데이터는 지워지지 않고 계속 누적되는 비대칭 구조. AI 단계 상승마다 필요 데이터가 몇 배씩 뛰며, 생성형 AI 약 100ZB → 에이전틱 AI 200~300ZB, 퍼지컬 AI 500ZB 이상 수준으로 확대. 수요 측면에서는 AI 에이전트 확산과 추론 연산 일상화로 토큰 사용량 급증이, 공급 측면에서는 빅테크 CapEX 내 메모리 비중 확대 전망으로 시장 전체 파이프와 메모리 뒤편이 동시에 커지는 국면 ▶ SSD와 HDD가 역할을 나눠 맡는 하이브리드 스토리지 구조: SSD는 '속도'(50~250MBps), HDD는 '용량'을 담당하는데, 1ZB 저장공간 구축 비용이 SSD 약 81조원 vs HDD 약 1.5조원으로 50배 이상 벌어져 'SSD로 전부 대체'가 아닌 성격별 분담 구조로 시장이 이동. 특히 추론 사용량 급증으로 KV캐시(대화·문맥 정보를 임시 저장) 데이터가 폭증하면서, 자주 쓰는 데이터는 SSD가 캐시로 받고 용량이 차면 HDD로 옮겨 장기 보관하는 방식이 확산. 제조사 자료 기준 하이브리드 스토리지 적용 시 응답 속도(TTF)가 평균 75% 이상 개선 ▶ SSD·HDD 양축 과점 플레이어 4개사에 집중 투자: SSD 축에서 '마이크론'은 전략적 고객계약(SCA) 16건과 향후 5년간 약 1천억 달러(약 155조원) 규모 공급계약을 확보해 26~30년 매출의 25%(장기 40%까지 확대 전망)를 선점했고, '샌디스크'는 미국 유일 NAND 퓨어플레이어로 AI 데이터센터용 매출이 분기 평균 39% 성장하며 전사 성장률을 상회. HDD 축은 '웨스턴디지털' 43%·'씨게이트' 40%로 두 회사가 시장의 83%를 차지하는 과점 구조라 수혜 집중이 기대되며, 고용량화와 총 용량 출하량 증가세가 중장기적으로 이어지는 중														
참고자료	저장 용량 수요 증가 속 수혜가 예상되는 메모리 기업에 집중 투자하는 'KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 ETF'가 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>생성형 AI</th><th>에이전틱 AI</th><th>퍼지컬 AI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주요 특징</td><td>텍스트·이미지·영상 콘텐츠 생성</td><td>장기 문맥·다중 작업 지속적 추론</td><td>영상·센서·3D데이터 실시간 활용</td></tr> <tr> <td>필요 데이터</td><td>~100ZB</td><td>200~300ZB</td><td>500ZB~</td></tr> </tbody> </table> 데이터 생성·처리량 증가 저장 용량 수요 지속 확대 고성능 SSD + 대용량 HDD 수요 구조적 증가 자료: 삼성자산운용 주) 상기 내용은 향후 달라질 수 있음			구분	생성형 AI	에이전틱 AI	퍼지컬 AI	주요 특징	텍스트·이미지·영상 콘텐츠 생성	장기 문맥·다중 작업 지속적 추론	영상·센서·3D데이터 실시간 활용	필요 데이터	~100ZB	200~300ZB	500ZB~
구분	생성형 AI	에이전틱 AI	퍼지컬 AI												
주요 특징	텍스트·이미지·영상 콘텐츠 생성	장기 문맥·다중 작업 지속적 추론	영상·센서·3D데이터 실시간 활용												
필요 데이터	~100ZB	200~300ZB	500ZB~												

ETF 명 (코드)	HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ (0227L0)
개요	- 미국 에이전틱AI 모델 개발 및 관련 서비스 기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF
특징	- 에이전틱 AI 생태계를 지탱하는 미국 핵심 빅테크 및 인프라 업체에 투자하되, 엔트로픽·오픈AI 등 비상장 프론티어 모델 기업 상장 시 신속 편입을 설계에 담은 상품
기초지수	- Indxx US Agentic AI Top2+ Index
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 미국 상장 보통주 및 ADR 중 - 시가총액 1억 달러 이상 및 6개월 평균 일일거래대금 50만 달러 이상 - 최근 6개월 거래일 중 90% 이상 거래, 유동주식비율 10% 이상, 추가 1만 달러 이상 종목 제외 ▶ 선정기준: 에이전틱 AI 테마 키워드 스크리닝 및 LLM 어문분석 기반 유사도 평가로 10종목 선정 - 1차선정: 연례 보고서·공시 기반 키워드 스크리닝 25점 이상 기업 - LLM기반 어문분석을 통해 각 회사의 연례보고서·공시 등의 Agentic AI와의 유사도를 평가 - 편입종목 선정: LLM 표준화점수(80%) + 시가총액 표준화점수(20%)에 따라 10종목 선정 - 단, 상위 2종목은 '대규모 언어모델(LLM)' 키워드로 선정된 종목으로 구성 ▶ 비중결정방식: 1~2위 각 25%, 3~4위 각 10%, 5~10위 각 5%
출시 배경 및 투자포인트	▶ 대화형 AI에서 에이전틱 AI로의 패러다임 전환: 기존생성형 AI가 질문에 답을 정리해주는 수준이었다면, 에이전틱 AI는 목표 달성을 위해 스스로 판단하고 실행까지 완료하는 차세대 시스템. 핵심은 수익화 논리의 전환으로 "AI 인프라 투자비용을 회수할 수 있는가"라는 의문이 "연산량이 곧 매출" 프레임으로 바뀌었다는 점. 사람이 하던 수백~수천 시간의 업무를 AI가 스스로 완료하면서 연산량 증가가 곧 비용 절감·매출 증가라는 ROI로 연결되고, 미국 기업 AI 도입률도 약 55.7%로 기존 전망치(21.6%)의 2배 수준까지 올라오며 현장 확산 국면에 진입 ▶ 모델과 인프라를 함께 담은 밸류체인 Top2 집중 투자: AI 에이전트는 '두뇌(LLM) + 몸(Harness) + 도구'의 조합으로, 에이전틱 AI 도입은 똑똑한 모델 하나를 들여오는 게 아니라 이를 뒷받침하는 기술 인프라 전체를 갖추는 일. 따라서 특정 모델 개발사 한 곳에 올인하는 방식으로는 수혜를 온전히 누리기 어려움. 따라서 핵심 파운데이션 모델과 클라우드를 운영하는 '마이크로소프트', '아마존', '구글', '메타'와 기술 인프라를 제공하는 '델 테크놀로지스', '데이터독', '아리스타 네트워크', '팔로앨토 네트워크', '스노우플레이크', '크라우드스트라이크 홀딩스' 등 미국 핵심 빅테크 밸류체인에 집중 투자 ▶ 비상장 프론티어 모델 기업의 상장 시 신속 편입: '엔트로픽'·'오픈AI'처럼 비상장 상태라 직접 투자가 불가능했던 차세대 에이전틱 AI 핵심 종목이 증시에 상장 시, 지수 방법론상 포트폴리오에 빠르게 반영되도록 설계. 차세대 AI 대어의 상장 수혜를 미리 포지셔닝하려는 수요를 겨냥
참고자료	'HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ ETF'의 포트폴리오 구성 예시  자료: NH-Amundi 자산운용 주) 2026.09.03 기준. 구성종목 및 비중은 향후 운용전략, 시장 상황에 따라 변동 가능

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
08/25	0233A0	ACE 삼성전자 SK 하이닉스플러스채권혼합 50	683	삼성전자, SK 하이닉스에 각 20%씩, AI 반도체 관련 추가 1 종목에 10% 투자하고, 국고통안채에 50%를 투자하는 채권혼합형 ETF
08/25	0231Z0	KODEX 코리아 TDF2065 액티브 적격	205	2065 년을 목표 은퇴시점으로 하여, 위험자산(국내 주식형 ETF)과 안전자산(국내 채권형 ETF)의 비중을 조절하는 재간접형 적격 TDF ETF
08/25	0233J0	TIGER 삼성전자 SK 하이닉스미국채혼합 50	2,093	삼성전자와 SK 하이닉스에 각 25%씩 투자하고, 미국 단기국채에 나머지 50%를 투자하는 채권혼합형 ETF
09/01	0234N0	KIWOOM 삼성 SK 그룹 TOP4+	349	삼성그룹 및 SK 그룹 상장사 중 각 그룹 핵심 산업의 직·간접·관련 기업을 5 개씩(총 10 개) 선정하여, 투자하는 패시브 ETF
09/01	0232A0	MIDAS 머니마켓액티브	1,242	국공채, 회사채, 기업어음 등에 투자하는 국내 단기금리형 액티브 ETF
09/01	0233N0	RISE 글로벌 AI 낸드메모리반도체	145	한국·미국·일본의 NAND Flash 메모리 및 NAND 기반 스토리지 관련 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
09/01	0229F0	마이티 신약포커스바이오액티브	61	신약개발 파이프라인을 보유하고있거나 신약개발을 추진하는 국내 바이오 기업에 투자하는 액티브 ETF
09/08	0238P0	TIGER 미국 S&P500 미국채혼합 50	496	S&P500 지수 구성종목 및 잔존만기 1 년 이하의 미국 단기 국채에 50:50 비중으로 투자하는 채권혼합형 패시브 상품

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.9.11 기준

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.